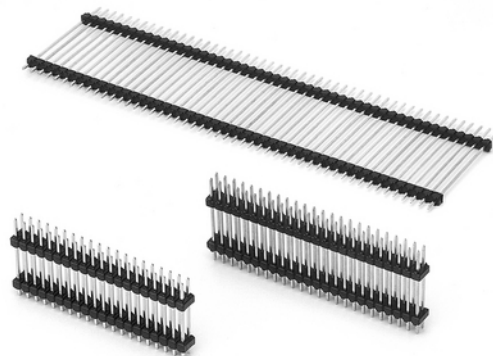


949 / 950 / 951

Sandwich-Stiftleisten RM 2,54mm, 1-/2-/3-reihig Dual Body Pin Headers, 2.54mm Pitch, 1/2/3 Rows

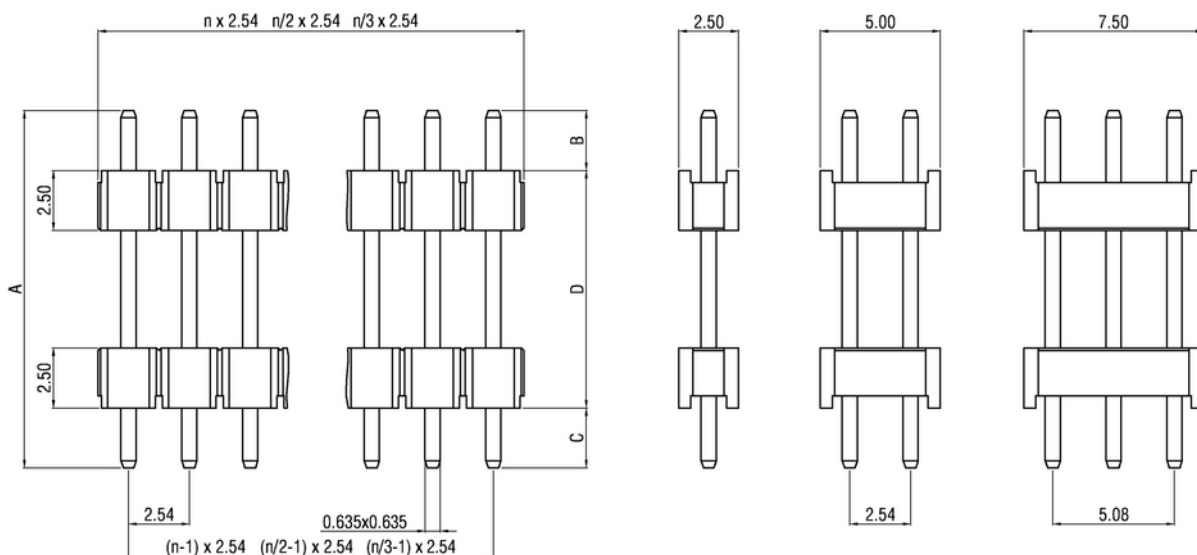
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung <i>Square pin 0.635mm, copper alloy</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	IEC 60512-12A <i>IEC 60512-12A</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ <i>< 20mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ <i>> 1000MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1kV _{DC} <i>1kV_{DC}</i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250V _{AC} <i>250V_{AC}</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3A <i>3A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40°C ... +105°C <i>-40°C ... +105°C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten Serien:
Mate with Female Header Series:
153 154 157 159 160/162 624 etc.
Weitere siehe Kapitel B
Please see ch. B for more



Series*

949

Gestanzte/geprägte Kontakte

Stamped/formed contacts

949 Einreihig

Single row

950 Zweireihig

Double row

951 Dreireihig

Triple row

Dimensions*

19

16	A=17,70 B=5,70 C=3,30 D=8,70mm
17	A=19,80 B=5,70 C=3,30 D=10,80mm
18	A=21,60 B=5,70 C=3,30 D=12,60mm
19	A=22,80 B=5,70 C=3,30 D=13,80mm
20	A=24,90 B=5,70 C=3,30 D=15,90mm
21	A=26,70 B=5,70 C=3,30 D=17,70mm
22	A=29,00 B=5,70 C=3,30 D=20,00mm
23	A=30,80 B=5,70 C=3,30 D=21,80mm
24	A=37,80 B=5,70 C=3,30 D=28,80mm
25	A=40,80 B=5,70 C=3,30 D=31,80mm
26	A=45,30 B=5,70 C=3,30 D=36,30mm

Contacts*

010

001-050 Einreihig

Single row

004-100 Zweireihig

Double row

006-120 Dreireihig

Triple row

Plating*

00

00 Vergoldet

Gold plated

10 0,25µm Gold

0.25µm gold plated

30 0,75µm Gold

0.75µm gold plated

50 Verzinnt

Tin plated

60 Sel. Au 0,25µm / Sn

80 Sel. Au 0,75µm / Sn

B, C, D nach Kundenwunsch variierbar. Wir fertigen die Stiftleisten in jeder gewünschten Polzahl. Raster 5,08mm, 7,62mm, etc. oder Sonderraster auf Anfrage.
B, C, D variable acc. to customers' specifications.
We will manufacture the pin headers in every desired number of contacts. 5.08mm, 7.62mm, etc. and varying pitches on request.

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.

* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0
FAX +49 5223 98507-20

W+P PRODUCTS

E-MAIL sales@wppro.com
WEBSITE www.wppro.com

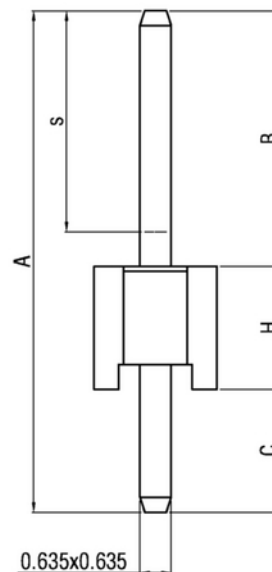
Stiftleistenmaße und PCB Layouts für 0,635mm Vierkantstifte

Dimensions and PCB Layouts

Gerade Stiftleisten / Straight Pin Headers

A : Gesamtstiftlänge / Overall Pin Length
B : Länge Steckseite / Mating Side Length
C : Länge Lötseite / Solder Side Length
H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height
s : Bereich der sel. Veredelung / Sel. Plated Area

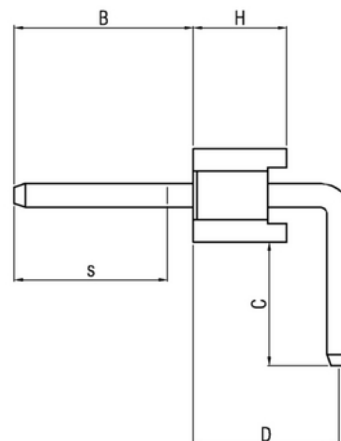
Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze
 Test point for s at 2-4mm from contact tip



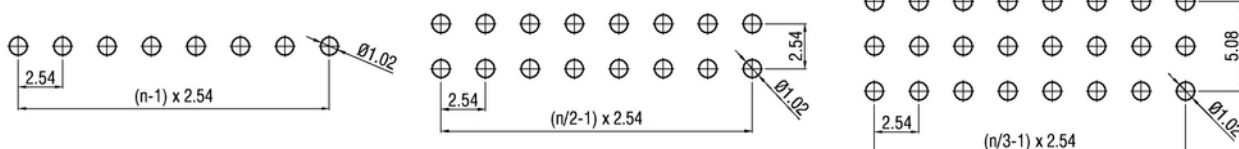
Gewinkelte Stiftleisten / Right-Angled Pin Headers

B : Länge Steckseite / Mating Side Length
C : Länge Lötseite / Solder Side Length
D : Abstand zu Steckseite / Distance to Mating Side
H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height
s : Bereich der sel. Veredelung / Sel. Plated Area

Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze
 Test point for s at 2-4mm from contact tip



PCB Layouts

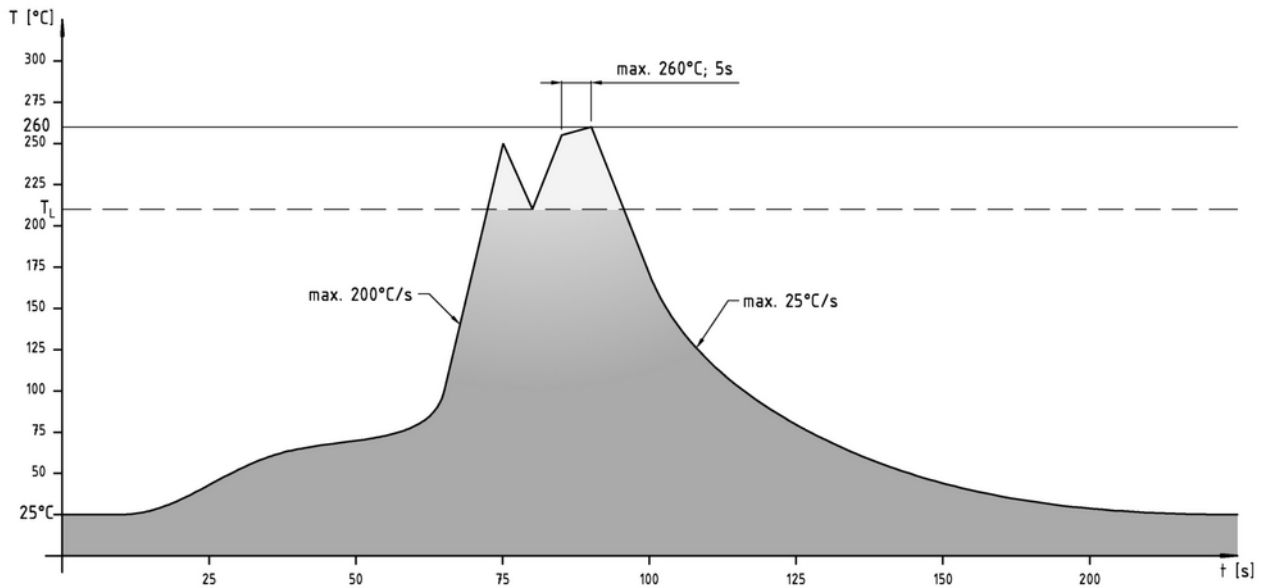


Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:



Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

